



## Vollautomatischer Bond-Tester 5600CS

### Bond / Test System

Testköpfe	Pullköpfe – 100cN – 5000 cN Shearheads – 500cN – 50000 cN Tweezerkopf– 100cN
-----------	--

### Maschinen Basis

#### Achsen

- Arbeitsbereich X/Y-Achse 100x100mm  
Z-Achse 60mm
- Schrittauflösung 0,25µm
- Wiederholgenauigkeit <2µm

#### Hardware

- Dual Core PC, 1,6 GHz Prozessor,
- 4 GB RAM, Ethernet, 4x USB-Hub Front
- Firewire CCD Farbkamera 1,4 MPixel
- Netzwerkfähig mit TCP/IP Server

#### Software

- Autom. Wiederholmessung an Hybriden oder COB durch programmierbaren X/Y Kreuztisch und 360° P-Achse,
- Statistik nach Mittelwert, Standardabweichung, Trend, cp, cpk auf Basis von SQL-Datenbanken
- Optionale Bildererkennung

**Geschwindigkeit** 20 Drähte ≤ Minute

**Abmessung** B x T x H – 70 x 65 x 70 cm, Gewicht ca. 80kg

**Anschlüsse** 100–240 VAC, 1 Phase, 50/60 Hz, max 500 VA  
Ø 6mm Standard-Vakuumschlauch

### Der 5600CS:

Der voll-automatische Bondtester 5600CS mit Kamera fügt sich hervorragend in das Geräteprogramm von F&S Bondtec rund ums Die- und Drahtbonden ein.

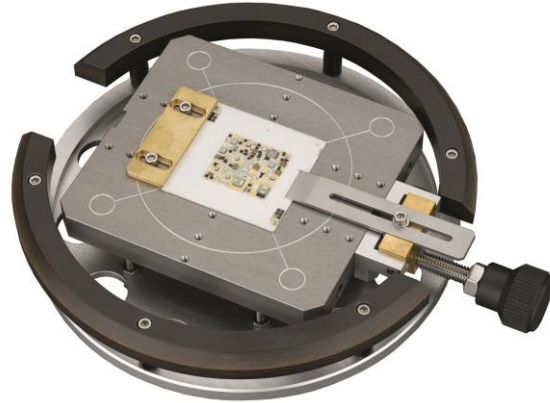
Nach der Erstellung eines Testprogrammes und dem durch eine Bilderkennung (PRU) unterstützten Adjusten, wird ein reproduzierbares und Benutzer unabhängiges Pullen oder Shearen auf allen erdenklichen Bauteilen gewährleistet.

Dieser Prozess ist weltweit einzigartig und wird nur von F&S Bondtec Semiconductor GmbH angeboten. Er ist voll PC gesteuert und kann mit seinem programmierbaren Kreuztisch zum automatischen Testen beliebig vieler Bonds eingesetzt werden. Die Testergebnisse werden je nach Wahl direkt analysiert und ausgegeben, oder direkt in eine kundenspezifische Datenbank exportiert.

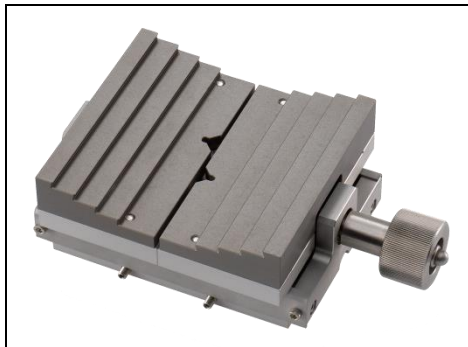
Ein besonderer Vorteil des 5600CS sind zusätzliche Messverfahren wie der Verlauf von Kraft/Zeit, die optimalen Aufschluss über den Verlauf der getesteten Bonds geben. Die wechselbaren Messköpfe machen den Pulltester flexibel für unterschiedliche Kraftbereiche; weitere Köpfe für Pull-, Shear-, und Tweezertests mit kundenspezifischen Tools und Klemmbacken sind verfügbar.

## Substrathalter

Standard-Substrataufnahme  
für Bauteile bis 4x4" mit  
Vakuum und mechanischer Klemmung



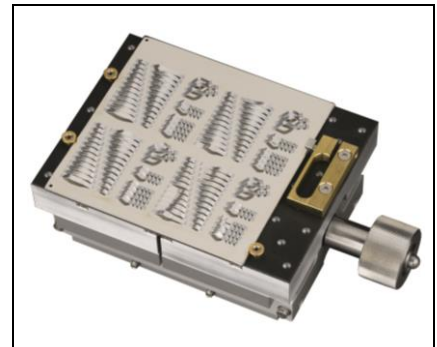
## Optional:



für Bauteile bis 4x4"  
mit Stufenbacken



TO Aufnahme mit  
mechanischer Klemmung



4x4" Substrataufnahme m.  
gummierter Oberfläche, mit  
mechanische Klemmung

**F&S Bondtec Semiconductor GmbH**

Industriezeile 49a

A-5280 Braunau am Inn

Tel.: +43-7722-67052-8270

Fax: +43-7722-67052-8272

Mail: [info@fsbondtec.at](mailto:info@fsbondtec.at)

Web: [www.fsbondtec.at](http://www.fsbondtec.at)

